

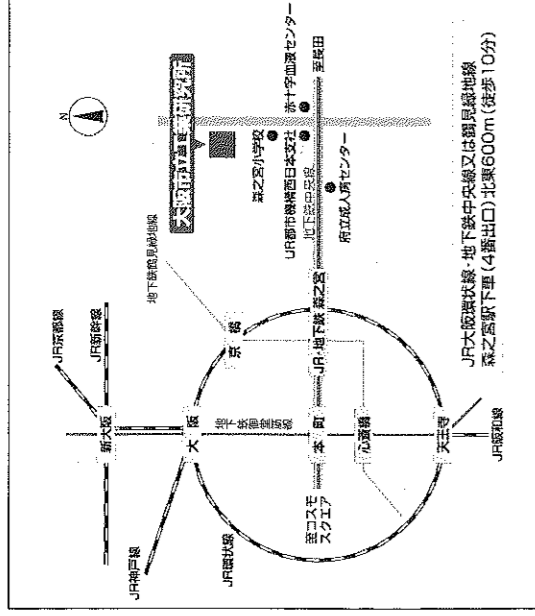
会場	〔I〕 大阪の部		会場：大阪市立工業研究所 大講堂	
期日	第1日：平成28年7月28日(木)		第2日：平成28年7月29日(金)	
受講受付	8時40分より		8時40分より	
時間	テーマ	講師	テーマ	講師
9時25分	会長挨拶	当協会会長 東京医科歯科大学名誉教授 工学博士 宮入 裕夫氏		
9時30分				
9時30分	熱可塑性エポキシ樹脂の開発～樹脂開発と構造材料分野への応用 従来のエポキシ樹脂とは異なる重合機構により、硬化後熱可塑性樹脂となる新規なシステムを開発した。開発経緯とその樹脂を用いたFRPや構造接着剤への応用に関する事例を紹介する。	ナガセケムテックス株式会社 機能樹脂事業部 技術顧問 金沢工業大学 研究員 工学博士 西田 裕文氏	塗料用水性エポキシ樹脂について 近年徐々に水性化が進んでいる防食塗料用に最適な水性エポキシ樹脂の設計思想とその特長について講演する。	D I C株式会社 ポリマ第一技術本部 ポリマ技術1グループ 主任研究員 工学博士 河原 英昭氏
10時30分	剛直骨格を導入したエポキシ樹脂の配向性と熱的・力学的特性 剛直骨格であるメソゲン基を導入したエポキシ樹脂の高熱伝導性や高Tg化について紹介する。	関西大学 化学生命工学部 准教授 工学博士 原田 美由紀氏	カーエレクトロニクスを支える半導体実装材料 車載向け半導体製品に用いられる実装材料について、その現状と今後の動向について解説する。	株式会社デンソー 半導体実装開発部 課長 今井 博和氏
11時30分	休 憩		休 憩	
11時40分	エポキシ系粉体塗料の新展開 低環境負荷、省資源なコーティング材料であるエポキシ系粉体塗料について、近年技術の新展開を述べる。	東亜合成株式会社 名古屋工場 機能製品課 丹羽 真氏	プリント配線板用ソルダーレジストの技術展開 プリント配線板に使用されるソルダーレジストについて、エポキシ樹脂を使用した熱硬化型から、アクリル変性したUV硬化、現像型に至る経緯とその特徴について解説する。	太陽ホールディングス株式会社 研究本部 フェロー 工学博士 稲垣 昇司氏
12時40分	昼 食		昼 食	
12時40分	昼 食		昼 食	
13時15分	高耐久性エポキシ樹脂トリグリシジルイソシアヌレートTEPIC®とその進化 先端電子産業では成型・印刷などの様々な加工法への対応が要求される。TEPIC®の耐久性を維持しながら、プロセス適合性を高めた素材を開発した。	日産化学工業株式会社 化学品事業部 企画開発部 係長 大森 健太郎氏	建築用接着剤 建築工事においては、非常に多くの種類の接着剤が使用されている。中でも改修工事における要求品質は多岐にわたり適材適所において様々な接着剤が使用されている。本講演では改修工事に関する接着剤の種類及びその用途について述べる。	セメダイン株式会社 開発部 研究第二グループ 市井 雅伸氏
14時15分	休 憩		休 憩	
14時25分	高耐熱性を有する半導体封止材の開発 パワー半導体向け封止材の高耐熱化、難燃化等の技術についてのアプローチを紹介する。	住友ベークライト株式会社 電子デバイス材料研究所 研究部 主任研究員 吉田 顕二氏	パワーモジュール用実装材料 電鉄・ハイブリッド自動車向けのパワーモジュールの市場が拡大している。エポキシ系封止材はモジュールの高信頼化に貢献している。この他、パワーモジュール用実装材料を概説する。	株式会社日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンター 主管研究員 技術士(化学部門) 工学博士 石井 利昭氏
15時25分	エポキシ樹脂の光硬化 光(または熱)潜在性硬化剤を用いたエポキシ樹脂の硬化について筆者らの研究例を中心に解説する。	東京理科大学 理工学部 工業化学科 准教授 工学博士 有光 晃二氏	航空機・自動車におけるCFRP適用の現状と展望一特に新しい樹脂を用いたCFRP技術の動向一 航空機・自動車におけるCFRP適用の現状について説明する。特にエポキシ樹脂関係の高圧RTMや脱オートクレーブ技術について説明するとともに、ライバルである熱可塑性CFRP技術動向も展望する。	名古屋大学 ナショナルコンポジットセンター 特任教授 センター担当総長補佐 工学博士 石川 隆司氏
16時25分	休 憩		休 憩	

技術四十回公開

エポキシ樹脂の高機能化技術を探る

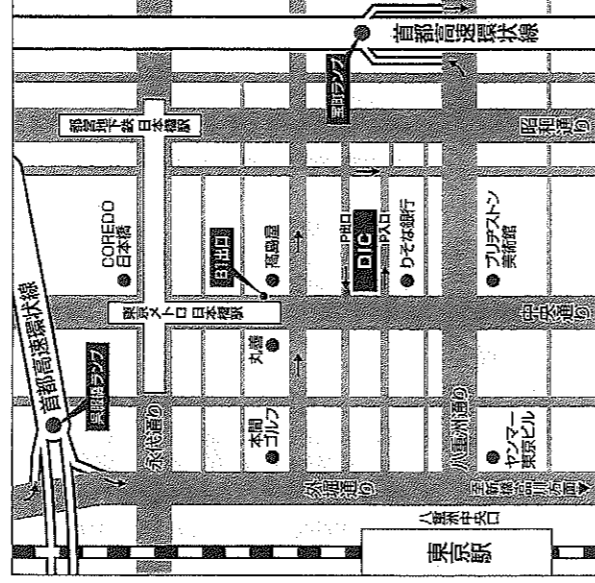
会場	〔II〕 東京の部		会場：DIC株式会社 本社 大会議室	
期日	第1日：平成28年8月4日(木)		第2日：平成28年8月5日(金)	
受講受付	8時50分より		8時50分より	
時間	テーマ	講師	テーマ	講師
9時25分	会長挨拶	当協会会長 東京医科歯科大学名誉教授 工学博士 宮入 裕夫氏		
9時30分				
9時30分	高耐久性エポキシ樹脂トリグリシジルイソシアヌレートTEPIC®とその進化 先端電子産業では成型・印刷などの様々な加工法への対応が要求される。TEPIC®の耐久性を維持しながら、プロセス適合性を高めた素材を開発した。	日産化学工業株式会社 化学品事業部 企画開発部 係長 大森 健太郎氏	建築用接着剤 建築工事においては、非常に多くの種類の接着剤が使用されている。中でも改修工事における要求品質は多岐にわたり適材適所において様々な接着剤が使用されている。本講演では改修工事に関する接着剤の種類及びその用途について述べる。	セメダイン株式会社 開発部 研究第二グループ 市井 雅伸氏
10時30分	プリント配線板用ソルダーレジストの技術展開 プリント配線板に使用されるソルダーレジストについて、エポキシ樹脂を使用した熱硬化型から、アクリル変性したUV硬化、現像型に至る経緯とその特徴について解説する。	太陽ホールディングス株式会社 研究本部 フェロー 工学博士 稲垣 昇司氏	塗料用水性エポキシ樹脂について 近年徐々に水性化が進んでいる防食塗料用に最適な水性エポキシ樹脂の設計思想とその特長について講演する。	D I C株式会社 ポリマ第一技術本部 ポリマ技術1グループ 主任研究員 工学博士 河原 英昭氏
11時30分	休 憩		休 憩	
11時40分	剛直骨格を導入したエポキシ樹脂の配向性と熱的・力学的特性 剛直骨格であるメソゲン基を導入したエポキシ樹脂の高熱伝導性や高Tg化について紹介する。	関西大学 化学生命工学部 准教授 工学博士 原田 美由紀氏	エポキシ系粉体塗料の新展開 低環境負荷、省資源なコーティング材料であるエポキシ系粉体塗料について、近年技術の新展開を述べる。	東亜合成株式会社 名古屋工場 機能製品課 丹羽 真氏
12時40分	昼 食		昼 食	
12時40分	昼 食		昼 食	
13時15分	熱可塑性エポキシ樹脂の開発～樹脂開発と構造材料分野への応用 従来のエポキシ樹脂とは異なる重合機構により、硬化後熱可塑性樹脂となる新規なシステムを開発した。開発経緯とその樹脂を用いたFRPや構造接着剤への応用に関する事例を紹介する。	ナガセケムテックス株式会社 機能樹脂事業部 技術顧問 金沢工業大学 研究員 工学博士 西田 裕文氏	カーエレクトロニクスを支える半導体実装材料 車載向け半導体製品に用いられる実装材料について、その現状と今後の動向について解説する。	株式会社デンソー 半導体実装開発部 課長 今井 博和氏
14時15分	休 憩		休 憩	
14時25分	高耐熱性を有する半導体封止材の開発 パワー半導体向け封止材の高耐熱化、難燃化等の技術についてのアプローチを紹介する。	住友ベークライト株式会社 電子デバイス材料研究所 研究部 主任研究員 吉田 顕二氏	パワーモジュール用実装材料 電鉄・ハイブリッド自動車向けのパワーモジュールの市場が拡大している。エポキシ系封止材はモジュールの高信頼化に貢献している。この他、パワーモジュール用実装材料を概説する。	株式会社日立製作所 研究開発グループ 材料イノベーションセンター 主管研究員 技術士(化学部門) 工学博士 石井 利昭氏
15時25分	エポキシ樹脂の光硬化 光(または熱)潜在性硬化剤を用いたエポキシ樹脂の硬化について筆者らの研究例を中心に解説する。	東京理科大学 理工学部 工業化学科 准教授 工学博士 有光 晃二氏	航空機・自動車におけるCFRP適用の現状と展望一特に新しい樹脂を用いたCFRP技術の動向一 航空機・自動車におけるCFRP適用の現状について説明する。特にエポキシ樹脂関係の高圧RTMや脱オートクレーブ技術について説明するとともに、ライバルである熱可塑性CFRP技術動向も展望する。	名古屋大学 ナショナルコンポジットセンター 特任教授 センター担当総長補佐 工学博士 石川 隆司氏
16時25分	休 憩		休 憩	

(大阪会場) 大阪市立工業研究所 大講堂  
〒536-8553 大阪市城東区森之宮1-6-50  
TEL 06-6963-8011~3



(交通) JR大阪環状線・地下鉄中央線又は鶴見線  
森之宮駅下車(4番出口)北東600m(徒歩10分)

(東京会場) DIC株式会社 本社 大会議室  
〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7 アイシービル  
TEL 03-6733-3000



エポキシ樹脂技術協会主催

第40回公開技術講座

# エポキシ樹脂の高機能化 技術を探る

大阪：平成28年7月28日(木)・29日(金)

大阪市立工業研究所 大講堂

東京：平成28年8月4日(木)・5日(金)

DIC株式会社 本社 大会議室

主催 エポキシ樹脂技術協会

東京都新宿区ケ谷砂土原町1-2  
〒162-0842 タイホービル 102号  
電話 03-3260-1721  
FAX 03-3235-9012  
URL: <http://homepage2.nifty.com/epoxygk>

## 会員お申込要領

### 1. 会員聴講料

会員区分	無料分	有料分
正会員	東京または大阪 1名 無料	18,000円
維持会員及 特別維持会員	東京・大阪を合せて 2名 無料	18,000円

### 2. 申込方法 (締切り) 大阪会場 7月26日 東京会場 8月2日

#### 1) 無料分のお申込

各会員の当協会担当者(窓口)宛にお送りした会  
員無料分申込書に御記入の上協会宛お送り下さい。  
折返し聴講券をお送りします。

#### 2) 有料分のお申込

聴講料(18,000円)以外は一般(非会員)と同じ  
です。右の一般(非会員)申込要領をご参照  
下さい。

### ※講演要旨集の事前配布

聴講申込みの方の内、希望者には送料受取人払い  
の宅配便にて講演要旨集の事前配布を行います。  
ご希望の方は申込み書の所定欄に記入して下さい。

## 一般(非会員)お申込要領

### 1. 聴講料

35,000円(講演要旨集代、昼食代を含む)

### 2. 申込方法 (締切り) 大阪会場 7月26日 東京会場 8月2日

本案内状の申込書(東京、大阪、別々の用紙にご  
記入下さい)を協会宛郵送又はFAXにて連絡の  
上、聴講料を指定銀行に振込んで下さい。折返し  
聴講券及び領収書をお送り致します。開催前1週  
間以内にお振込の場合には聴講券及び領収書は当日  
会場受付にてお受け取り下さい。聴講料の請求書  
入用の場合は聴講申込書にその旨ご記入下さい。  
また、当協会のホームページからも申込できます。  
(<http://homepage2.nifty.com/epoxygk>)

### 3. 申込先

東京都新宿区ケ谷砂土原町1-2  
〒162-0842 タイホービル 102号  
エポキシ樹脂技術協会 電話 03(3260)1721  
FAX 03(3235)9012

### 4. 振込先

みずほ銀行市ヶ谷支店 普通口座 1124935

エポキシ樹脂技術協会

尚、お振込の際は個人名でなく会社名を入れてお  
願い致します。個人名だけでは確認が困難で聴講  
券の発送に支障をきたす場合があります。

### 5. ご注意

聴講料の払戻しは致しませんので、お申込者にご  
都合のある場合は、代理の方が参加して下さい。  
また、講演要旨集は別売致しませんので、ご了承下さい。

エポキシ樹脂技術協会主催  
第40回公開技術講座

## 大阪 会場申込書 会員有料分・一般(非会員)

(左の会員・非会員  
の該当を○で囲ん  
で下さい。)

貴社名	聴講者ご氏名	同左所属部課	聴講料 円
聴講券 領収証 送り先 (1) 電話	(〒 - )		銀行振込予定 みずほ銀行市ヶ谷支店 平成28年 月 日 聴講料請求書 要 不要
聴講券 領収証 送り先 (2) 電話	(〒 - )		講演要旨集事前配布 (送料受取人払い) 要 不要

2名以上の申し込みで聴講券の発行先が2ヵ所になる場合は聴講者氏名に(1)又は(2)を附して区別して下さい。

エポキシ樹脂技術協会主催  
第40回公開技術講座

## 東京 会場申込書 会員有料分・一般(非会員)

(左の会員・非会員  
の該当を○で囲ん  
で下さい。)

貴社名	聴講者ご氏名	同左所属部課	聴講料 円
聴講券 領収証 送り先 (1) 電話	(〒 - )		銀行振込予定 みずほ銀行市ヶ谷支店 平成28年 月 日 聴講料請求書 要 不要
聴講券 領収証 送り先 (2) 電話	(〒 - )		講演要旨集事前配布 (送料受取人払い) 要 不要

2名以上の申し込みで聴講券の発行先が2ヵ所になる場合は聴講者氏名に(1)又は(2)を附して区別して下さい。